

アルカリ現像型PKG用DFSR AUS SR3

Photo-imageable Solder Resist for Ultra Thin/ Coreless application
(薄型、コアレスサブストレート対応)

特徴 Features

- 高弾性率/高剛性 High Modulus & Stiffness
- 低CTE/ 高Tg Low CTE/ High Tg
- 高強度 High Strength
- 優れた解像性 High Resolution
- ドライフィルムタイプ Dry film type

特性 Properties

ガラス転移点 Tg *TMA method	150-160deg.C
線膨張係数 CTE (α_1)	15-20 ppm
弾性率 Young's modulus *DMA method	12.5-13.5 Gpa
破壊強度 Tensile strength	90-100 Mpa
破壊伸び率 Elongation	2.0-3.0 %
HAST耐性 (130deg.C/85%RH, 5V,L/S=12/13)	300h Pass

